



HY-P Series

导热界面材料 Thermal Interface Material

专为电子零部件降温设计的导热界面材料
Special Design for Electronic Components Heat Transfer

项目 Items	HY-P7	HY-P11	HY-P13	HY-P14	HY-P15	HY-P16 PTM	单位 Unit
颜色 Color	灰色 Grey	灰色 Grey	灰色 Grey	灰色 Grey	灰色 Grey	灰色 Grey	No
热传导系数 Thermal Conductivity	7.35 ~ 16.1						W/m-k
热阻抗 Thermal Impedance	<0.0015	<0.0012	<0.001	<0.0009	<0.0008	<0.0007	°C-in ² /W
比重 Specific Gravity	2.07	3.47	2.5	2.5	2.5	2.5	g/cm ³
浓度 Thixotropic Index	370±10	340±10	350±10	320±10	280±10	390±10	1/10mm
瞬间耐温度 Moment Bore Temperature	-30-150	-30-150	-30-150	-30-150	-30-150	-30-150	°C
工作温度 Operation Temperature	-20-130	-20-130	-20-130	-20-130	-20-130	-20-130	°C

成份 Ingredients

矽化合物 Silicone Compounds	15%	12%	15%	30%	13%	28%	%
碳化合物 Carbon Compounds	30%	28%	25%	10%	12%	10%	%
氧化金属化合物 Metal Oxide Compounds	55%	60%	60%	60%	75%	62%	%
包装 Package	针管			吊卡			
	TU	Other					
	0.5g-30g			0.5g-5g			

产品图片 Products Pictures



执行标准: Q/HYTG 001-2017

※本产品耐温,阻燃,一般常温储存方式即可

Thermal Interface Materials Temperature Resistant, Flame Retardant and Storage at room temperature

以上数据由深圳市华能智研电子有限公司实验室测试所得,该实验室保留最终解释权

All data above are provided Shenzhen Halnziye Electronics Co.,Ltd. Halnziye All Rights Reserved

